【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成19年3月29日(2007.3.29)

【公開番号】特開2000-251778(P2000-251778A)
【公開日】平成12年9月14日(2000.9.14)
【出願番号】特願平11-48894
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｊ　29/90　　(2006.01)
Ｇ０９Ｆ　 9/30　　(2006.01)
Ｈ０１Ｊ　 9/32　　(2006.01)
Ｈ０１Ｊ　31/12　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｊ　29/90
Ｇ０９Ｆ　 9/30　　Ｃ
Ｇ０９Ｆ　 9/30　３４８Ａ
Ｈ０１Ｊ　 9/32　　Ａ
Ｈ０１Ｊ　31/12　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成19年2月14日(2007.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
配線が設けられた基板と、支持枠と、を含む気密容器の製造方法であって、
基板上に、金属粒子とガラスとを含むペーストを塗布し焼成して配線を形成する工程と、
前記配線に、前記ガラスと同じ材料からなるガラスを含浸させる工程と、
前記ガラスを含浸させた配線上にフリットガラスを設け、該フリットガラスに支持枠を接着し、該支持枠と前記基板とを封着する工程と、
を含むことを特徴とする気密容器の製造方法。
【請求項２】
前記金属粒子は、Ａｇから構成されることを特徴とする請求項１に記載の気密容器の製造方法。